

華通電腦股份有限公司

COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD.

2026 年 5 月

(2313.TW)

免責聲明

- 除歷史事件之陳述外，本文件均為前瞻性敘述。該前瞻性敘述包括已知及未知風險、不確定性及其他可能導致華通電腦股份有限公司之實際表現、財務狀況或營運結果與該前瞻性敘述所包含者產生重大差別之因素。
- 本免責聲明中之財務預測及前瞻性敘述為目前華通電腦股份有限公司截至本文件之日之信念所編製。華通電腦股份有限公司不負責更新這些預測及前瞻性敘述以反映此日期後所發生之事件或情況。
- 歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前華通電腦股份有限公司之財務狀況或營運結果。

COMPEQ

華通專注於提供一站式服務滿足客戶各項產品需求



硬性電路板

衛星通訊
資料中心
光通模組
汽車電子
智慧手機
筆電、平板



軟性電路板

電池管理模組
顯示器模組
攝像模組
穿戴裝置
周邊電子配件



軟硬結合電路板

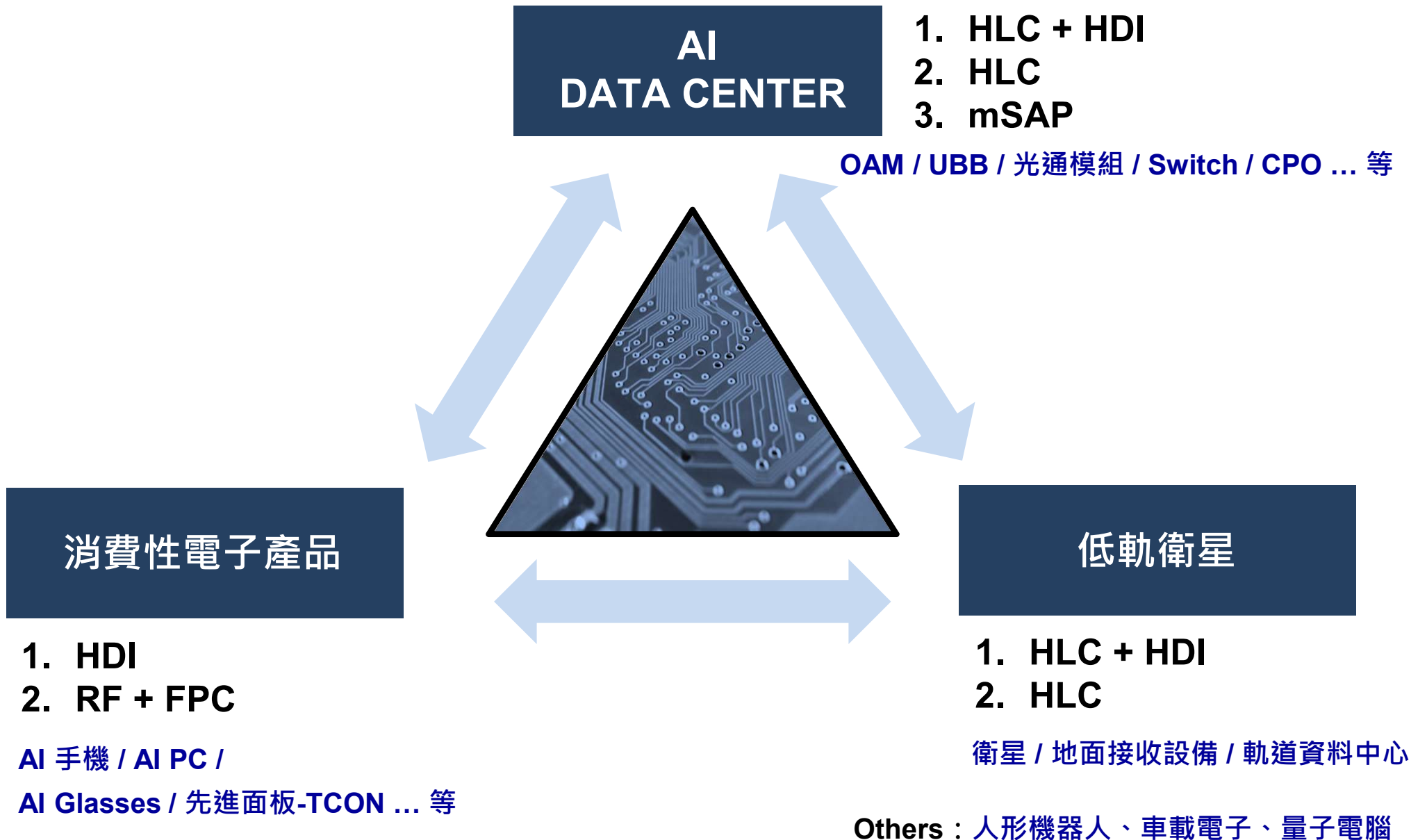
穿戴裝置
攝像模組
顯示器模組
電池管理模組



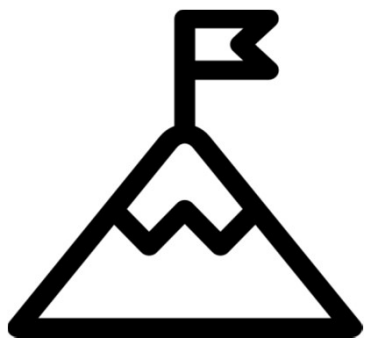
表面黏著技術

電池管理模組
汽車電子
光通模組
醫療電子
周邊電子配件

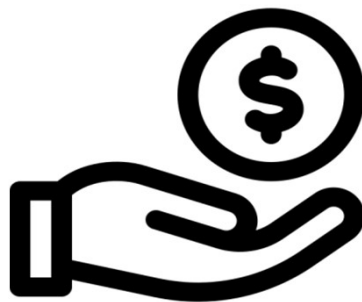
華通 PCB 未來市場及產品策略



華通是全球頂尖的 PCB 供應商



全球PCB供應商 **No. 8**



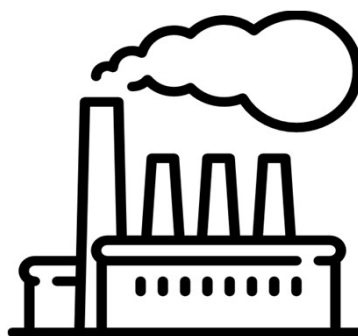
2025年營收
新台幣 **760 億**



2014-2025 營收
年複合成長率 **7.3%**



20,000+ 員工



8 座高科技且具成本競爭力的
工廠設置於**台灣、大陸和泰國**

Compeq Thailand

Location: AIES Samut Prakan (30 km away from BKK airport)

Land area: 180,000 m²

Investment: 300 M USD

Mass production: Q1'25

Capa: 400,000 sf/month

華通全球廠區及據點分布



重慶 II 廠
Y2021
900人
92,000 M²



泰國廠
Y2024
1,500人
66,000 M²



重慶 I 廠
Y2014
2,600 人
56,000 M²



蘇州
Y2004
700 人
42,000 M²



惠州 SMT
Y2012
3,500 人
60,000 M²



惠州軟板
Y2004
4,700 人
150,000 M²



惠州
Y1996
3,300 人
151,000 M²



大園
Y1998
1,200 人
42,000 M²



蘆竹
Y1973
3,300 人
90,000 M²

華通競爭優勢

品質

在優異的品質管制系統下，提供高品質，高一致性，高信賴度、低缺點率的產品。

技術

領先導入 **mSAP** 類載板製程，提供 **20 / 20 μ m** 細線路 **Anylayer** 薄板到 **52 層 6 mm** 高信賴度厚板，以及軟板和軟硬結合板。

ESG

符合法令規範，重視環境保護，注重勞工權益，公司治理。

服務

提供硬板、軟板、軟硬結合板，和打件的一站式電路板服務，並且和客戶共同開發新產品，參與早期設計開發階段，提供到製造、打件、出貨的完整服務。

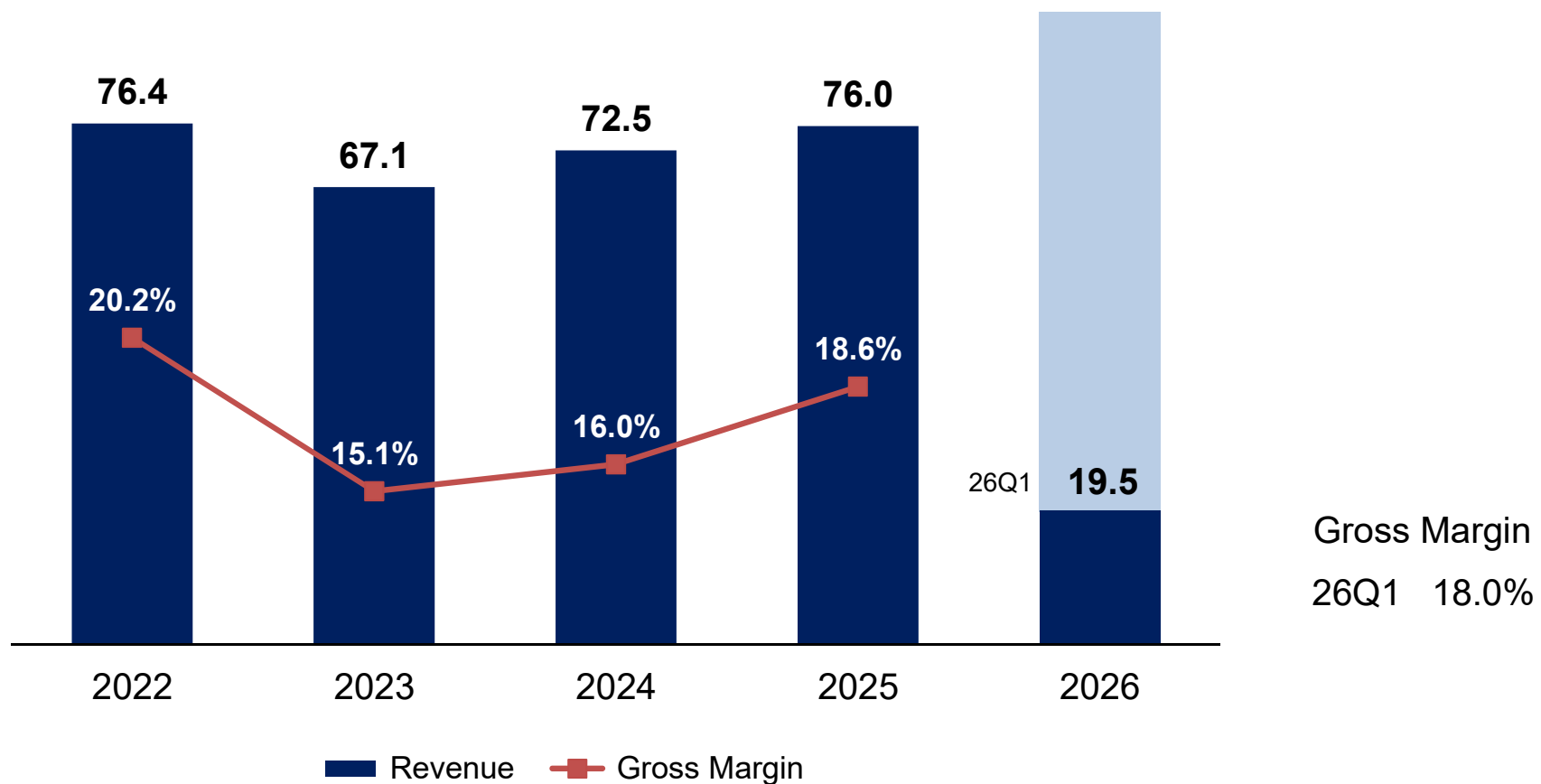
長久關係

穩定經營與成長，擅於研發新技術，掌握客戶需求，提前做好準備，成為客戶共同發展的合作夥伴。

華通營收規模與毛利趨勢

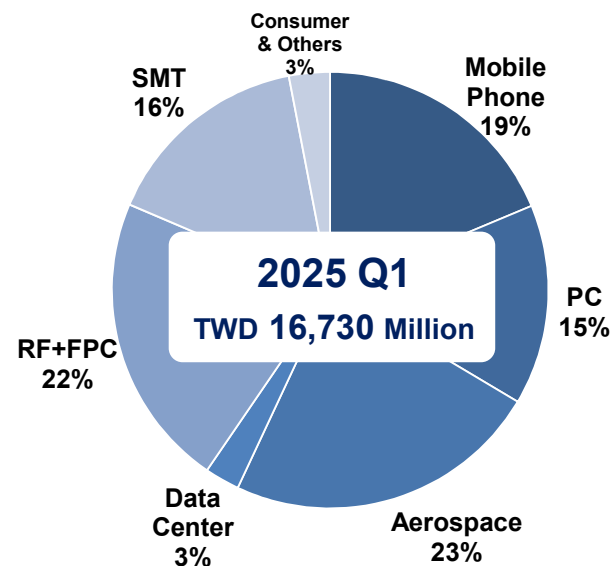
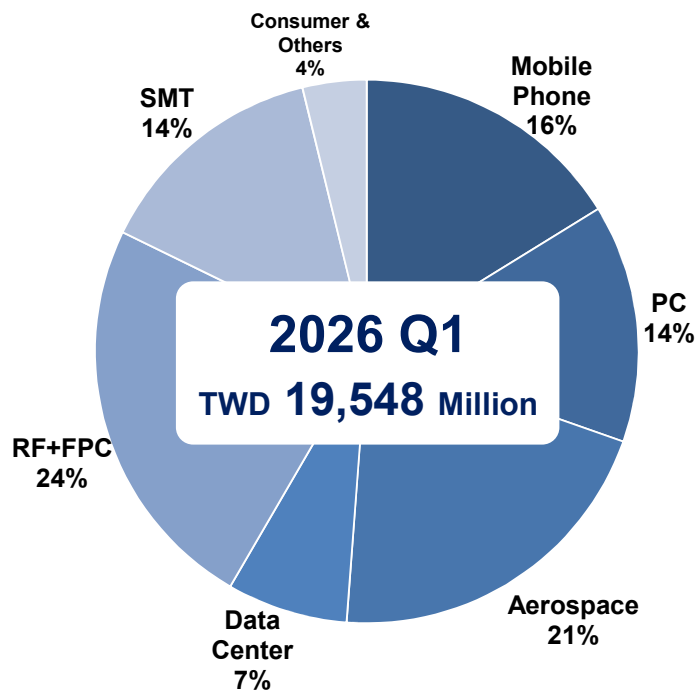
Compeq Revenue and Gross Margin from 2022 to 2026Q1

Unit: Bn TWD



Gross Margin
26Q1 18.0%











華通本期營收組成



	Mobile Phone	PC	Data Center	RF + FPC	SMT	Aerospace	Consumer & Others
2025 Q1	19%	15%	3%	22%	16%	23%	3%
2025 Q2	16%	16%	4%	25%	14%	22%	4%
2025 Q3	18%	13%	5%	28%	16%	17%	4%
2025 Q4	22%	10%	6%	26%	15%	17%	4%
2026 Q1	16%	14%	7%	24%	14%	21%	4%
2026Q1 YoY	+1%	+12%	+225%	+27%	+5%	+4%	+46%

Total +17%

HDI PCB 市場主要供應商 / 華通排名

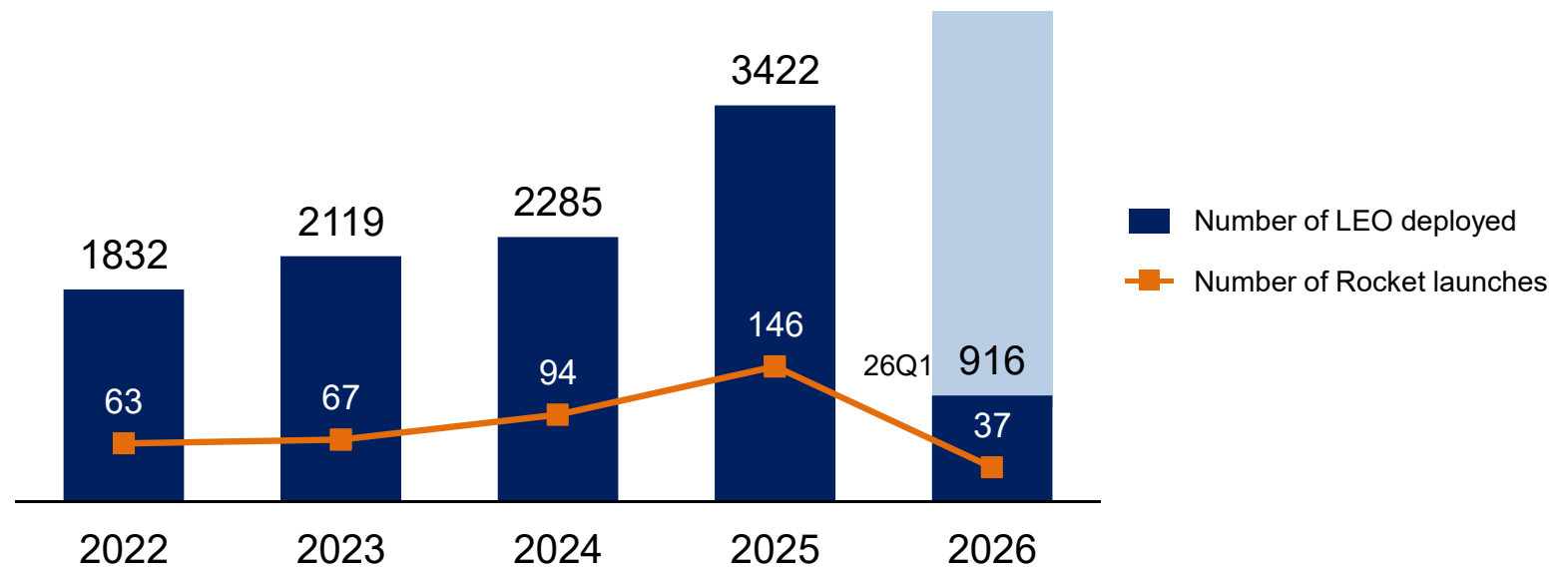
Rank	Country	Supplier	2025 Revenue (M USD)
1	TWN 	Compeq	\$ 1,381
2	CHN 	WUS Group	\$ 1,179
3	TWN 	Unimicron	\$ 1,144
4	CHN 	Victory Giant	\$ 1,117
5	TWN 	Zhen Ding	\$ 967
6	AUT 	AT&S	\$ 956
7	USA 	TTM	\$ 907
8	TWN 	Tripod	\$ 834
9	JPN 	Meiko	\$ 697
10	CHN 	AKM Meadville	\$ 628

Source: Prismark, 2026

產業趨勢與展望：低軌衛星

根據公開資料統計，全球前五大低軌衛星（LEO）營運商於 2025 年共執行 146 次火箭發射任務，部署 3,422 顆衛星；2026 年第一季已完成 37 次火箭發射，部署 916 顆衛星，整體發射頻率與衛星佈署量持續呈現成長趨勢。

Top 5 LEO Operators: Rocket Launches & Satellite deployed



Aggregated Data from the Top 5 LEO Satellite Operators

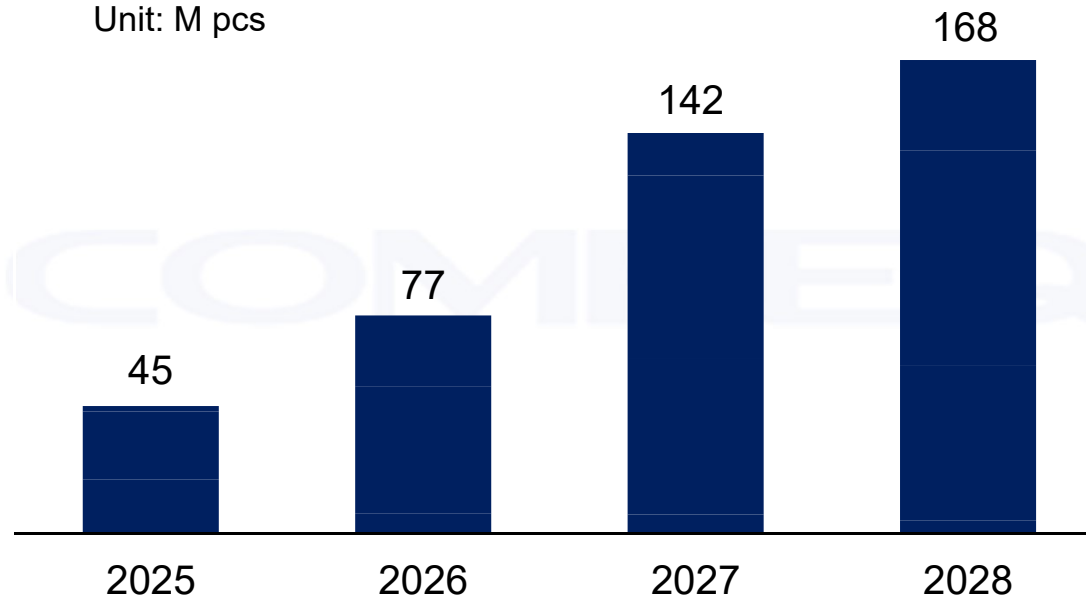
產業趨勢與展望：光通模組

光通模組因 AI 算力快速成長所帶動的高頻寬低延遲傳輸需求，市場正呈現顯著成長趨勢。400G、800G 以及 1.6T 光通模組需求快速提升，同步帶動高階 PCB 需求。

華通深耕高階光通訊模組所需的 mSAP 類載板技術已近十年，長期投入高精度線路、細線寬/線距、高層數 HDI 與高速材料製程，積極布局高速網通市場。

Global Shipment Forecast for 400G+ Optical Transceivers

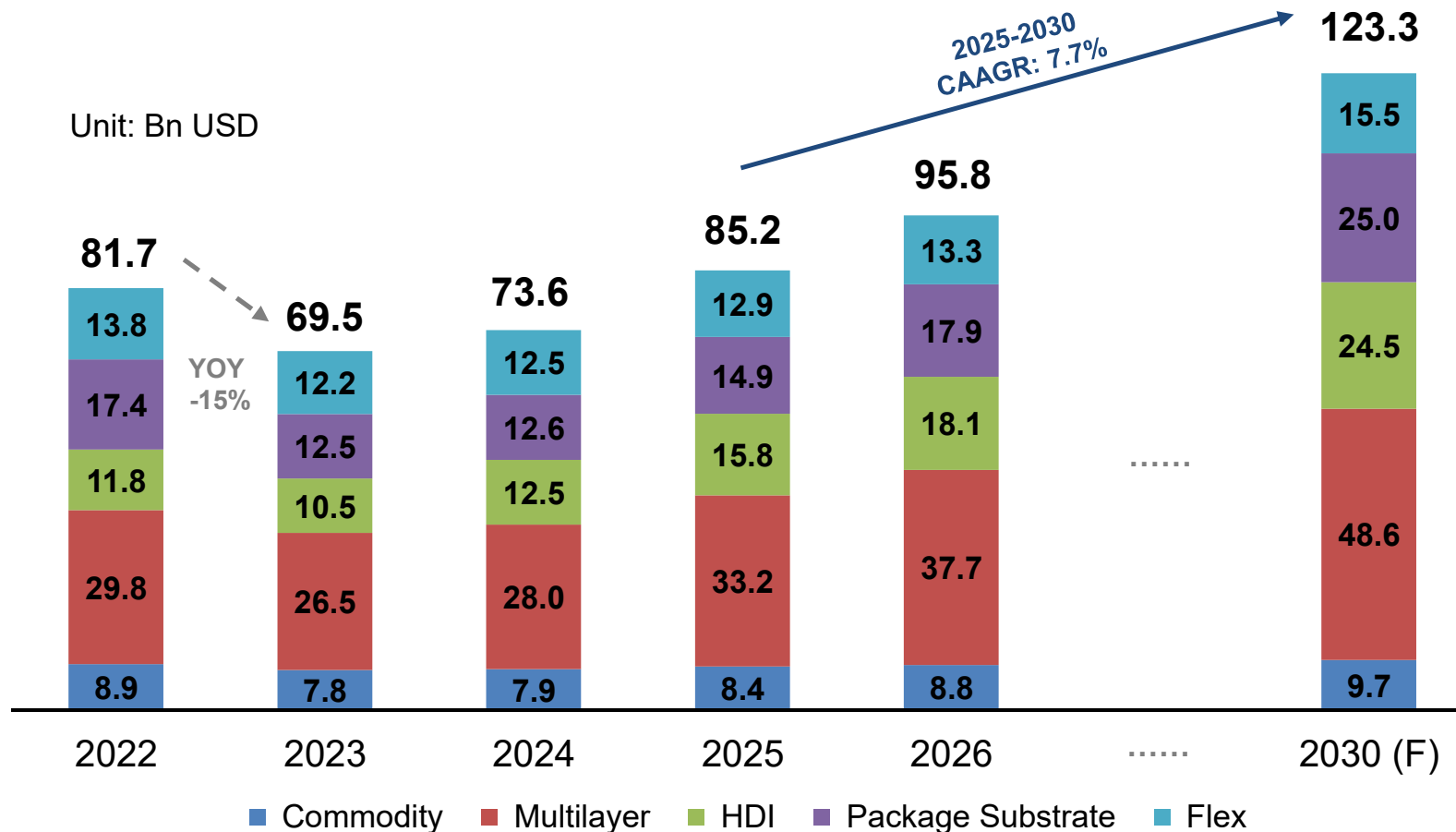
Unit: M pcs



Source: Market reports and Compeq internal data

PCB 產業趨勢

研究機構Prismark指出，整體PCB市場因AI科技的應用、高速運算/傳輸、衛星通訊、車用電子等產品需求成長，2025年PCB產值成長幅度約15.8%。2026年AI伺服器、交換器和其他網路產品的強勁需求持續帶動下，將成長12.5%。長期發展而言，電子產業將持續成長，預估2030年整體PCB產值將達1,233億美元，2025-2030年複合成長率7.7%。



Thanks For Your Attention

COMPEQ